

金橙子科技3D打印控制系统（SLA/SLM/SLS）

产品名称	金橙子科技3D打印控制系统（SLA/SLM/SLS）
公司名称	北京金橙子科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市丰台区丰台路口139号319室（注册地址）
联系电话	010-64426993 17800213780

产品详情

软件界面

系统架构

方案一

方案二

*注： DLC2-V3激光标刻控制卡+运动控制卡/ DLC2PCIE-V3激光标刻控制卡+运动控制卡

系统特征柔性

能适应加工对象变换的自动化机械激光加工。

高精度

异形工件上实现多角度jingque拼接的激光加工。

高效率

3D振镜控制技术，高效的三维激光加工技术。

系统优势精准

定位点二次补偿功能、光路偏移补偿、水口切割效果自动检测、加工条码后自动识别验证、分区域焦距补偿、支持总线方式控制驱动器、多种振镜协议支持、区域/顺序自定义补偿。

效率

大视野多产品定位、进出料供给、卷料裁切、多工位、多激光器、加工路径优化。

便捷

开放式Mes通讯、EMAPING、配合工厂闭环管理、内置CAD功能可对图档深度编辑、适配多个品牌激光器通讯控制、多种扫码方案、自定义工作流程便捷适配自动化需要。

系统性能多轴联动功能

协调激光扫描振镜和XY平台同时工作，最后得到远超振镜加工幅面的加工效果，相比传统的拼接方案，在保证了切割线条连续的效果，又有效的保留了振镜扫描加工的效率。

飞拍功能

在采集多个MARK点过程中，相机和工件保持相对运动状态，相比运动-稳定-采集图像的循环模式少了运动减速到静止的稳定时间，提升了生产效率。